

CSTM 标准征求意见表

项目编号：
标准名称：《封装基板用积层胶膜的溢胶量测试服方法》
征求意见截止日期 2025.6.30

项目工作组编号：
阶段（修改版本/日期）： 征求意见稿 2025.6

序号	评论单位 及姓名	章条号 图、表号	评论类型 G（一般性） T（技术性） E（编辑性）	评论及修改理由	修改建议	工作组决定 （如不采纳或部分采纳 需说明具体理由）